

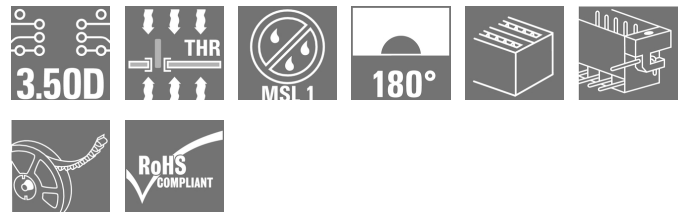
**S2C-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Термостойкий штекерный соединитель.**

- Защита от прикосновения
- Возможность подключения к гнездовому разъему B2CF 3.50 PUSH IN
- Направление подключения — перпендикулярно или параллельно печатной плате (180° / 90°)
- Варианты исполнения корпуса: закрытый (G) и с фланцем под пайку (LF)
- Упаковка — коробка (BX) или антистатическая лента на катушке (RL)
- Подходит для пайки оплавлением сквозных отверстий (Reflow) и волной припоя
- Длина выводов 1,5 или 3,5 мм.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 мм, Количество полюсов: 18, 180°, Длина контактного штифта (l): 1.5 мм, луженые, черный, Tape
Номер для заказа	<a href="#">1358710000</a>
Тип	S2C-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118161526
Кол.	175 Шт.
Продуктное отношение	IEC: 200 V / 13.4 A UL: 150 V / 10 A
Дата создания	7 апреля 2021 г. 17:13:13 CEST
Упаковка	Tape

**S2C-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	15,7 мм	Высота (в дюймах)	0,618 inch
Высота, мин.	14,2 мм	Глубина	10,8 мм
Глубина (дюймов)	0,425 inch	Масса нетто	5,836 g
Ширина	38,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,516 inch

**Упаковка**

Упаковка	Таре	Длина VPE	0
VPE с	0	Высота VPE	0
Глубина ленты (T2)	19,8 мм	Ширина ленты (Ш)	56 мм
Глубина ленты с кармашками (KO)	19,3 мм	Высота ленты с кармашками (A0)	11,1 мм
Ширина ленты с кармашками (BO)	42 мм	Разделение кармашка ленты (P1)	20 мм
Перфорация для разделения ленты (E)	1,75 мм	Разделение кармашка ленты (F)	26,2 мм
Диаметр катушки с лентой $\phi$ (A)	330 мм	Поверхностное сопротивление	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$
Ширина контактной площадки Pick & Place ( $W_{PPP}$ )	10 мм	Длина контактной площадки Pick & Place ( $L_{PPP}$ )	15,6 мм
Диаметр извлекаемой поверхности ( $\phi_{D_{max}}$ )	9 мм	Выступ 1 контактной площадки Pick & Place ( $L_{01 (PPP)}$ )	7,8 мм
Выступ 2 контактной площадки Pick & Place ( $P_{02 (PPP)}$ )	7,8 мм		

**Системные характеристики**

Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия B2C/S2C 3.50, 2-рядные	Вид соединения	Соединение с платой
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Шаг в мм (P)	3,5 мм
Шаг в дюймах (P)	0,138 inch	Угол вывода	180°
Количество полюсов	18	Количество контактных штырьков на полюс	1
Длина контактного штифта (l)	1,5 мм	Допуск на длину выводов под пайку	0 / -0,3 мм
Размеры выводов под пайку	d = 1,0 mm, восьмиугольный	Размеры выводов под пайку = допуск d	+0,01 / -0,03 мм
Диаметр монтажного отверстия (D)	1,3 мм	Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)	+ 0,1 мм
Наружный диаметр площадки под пайку	2,1 мм	Диаметр отверстия трафарета	1,9 мм
L1 в мм	28 мм	L1 в дюймах	1,102 inch
Количество рядов	1	Количество полюсных рядов	2
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106	защита от доступа пальцем	Защита от прикосновения согласно DIN VDE 04 70	IP 20
Кодируемый	Да	Усилие вставки на полюс, макс.	3,5 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.	2,5 N		

**S2C-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


**Технические данные****Данные о материалах**

Изоляционный материал	LCP GF	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIb
Сравнительный показатель пробоя (СТИ)	>= 175	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Медный сплав
Поверхность контакта	луженые	Структура слоев соединения под пайку	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый
Структура слоев штепсельного контакта	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	120 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-40 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C		

**Номинальные характеристики по IEC**

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	13,4 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	12 A	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	200 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	160 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	80 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	2,5 kV	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	2,5 kV	Устойчивость к воздействию кратковременного тока	3 x 1 сек. с 80 A

**Номинальные характеристики по CSA**

Институт (CSA)		Сертификат № (CSA)	200039-1121690
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)	150 V	Номинальное напряжение (группа использования C/CSA)	50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)	150 V	Номинальный ток (группа использования B/CSA)	9,5 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA)	9,5 A	Номинальный ток (группа использования D/CSA)	9,5 A
Ссылка на утвержденные значения	В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.		

**S2C-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Номинальные характеристики по UL 1059**

Институт (cURus)



Сертификат № (cURus)

E60693

Номинальное напряжение (группа использования В/UL 1059)	150 V	Номинальное напряжение (группа использования С/UL 1059)	50 V
Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)	10 A	Номинальный ток (группа использования С/UL 1059)	10 A
Ссылка на утвержденные значения	В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

**Важное примечание**

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Позолоченные контактные поверхности по запросу</li> <li>• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.</li> <li>• Промежуток между рядами: см. компоновку отверстий</li> <li>• Р на чертеже – шаг</li> <li>• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.</li> <li>• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев</li> </ul>

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E60693

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>

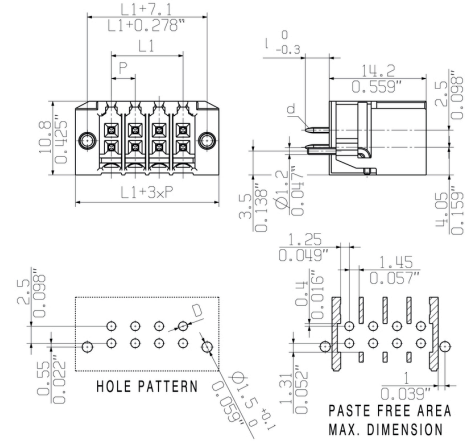
**S2C-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

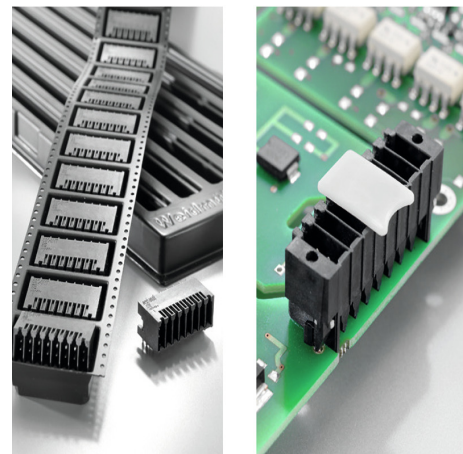
www.weidmueller.com

**Изображения**

**Dimensional drawing**



**Преимущество изделия**



Optimised for the SMT process  
 Safe board-to-board connection

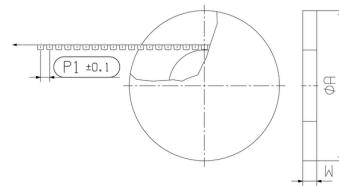
**S2C-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

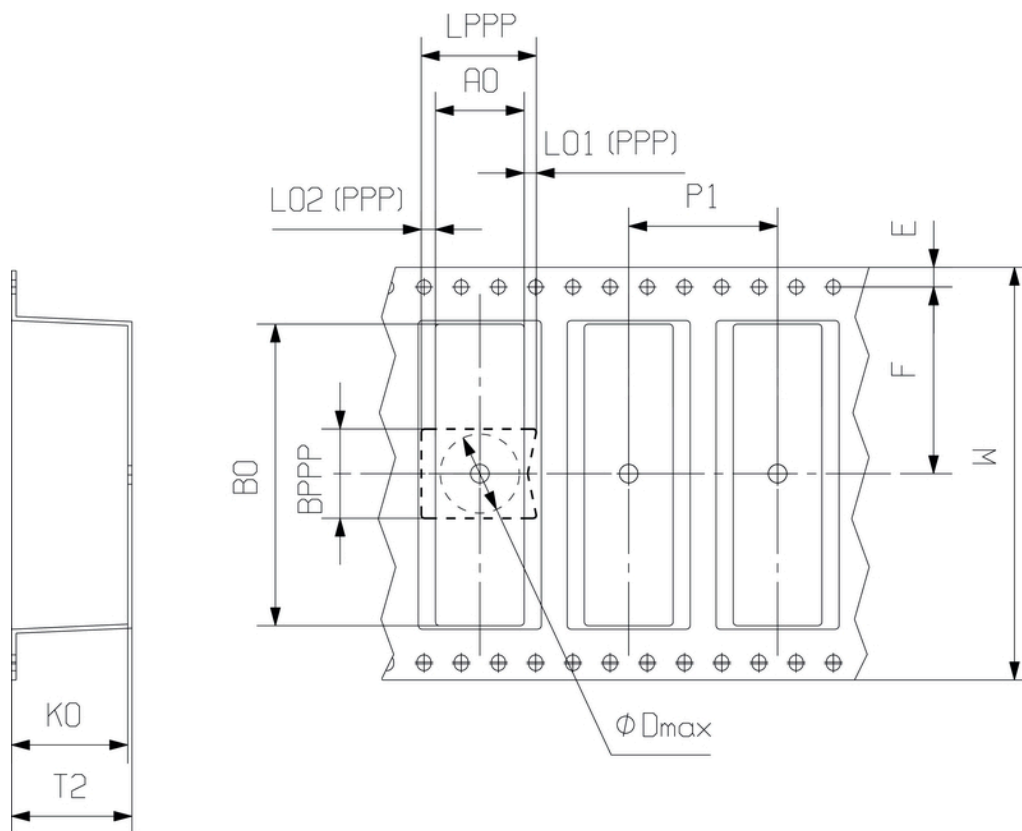
www.weidmueller.com

**Изображения**

**Dimensional drawing**



**Dimensional drawing**



DIRECTION OF UNREELING 

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klängenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.